

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p> 开源证券—刘翔、盛晓君（2021.10.20，时间：9：00—9：50，电话会议） 光大保德信基金管理有限公司—陈飞达 国寿养老—鲁嘉琪 国泰基金管理有限公司—刘波 海富通—王经纬 华安资产—李亚鑫 华宝—高小强 汇添富—徐逸舟 嘉实基金管理有限公司—华莎 摩根—施同亮 盘京—王莉 前海开源—张浩 上海焱牛投资管理有限公司—刘元平 深圳市凯丰投资管理有限公司—李名雅 太平基金—田发祥 泰康—邹志、张耀伟 天风资管—殷成钢 天弘—张磊 万家基金管理有限公司—章恒 盈峰资本—张珣 永赢基金—张海啸 长城基金管理有限公司—杨维维 中庚—谢昭懿 中邮—陈子龙 朱雀—徐斌毅 嘉实—孟丽婷 </p> <p> 方证证券—吴文吉、陈杭（2021.10.20，时间：10：00—10：50，电话会议） 拓璞基金—俞海海 敦和资管—李乾 泰康—周昊 </p>

弘尚资产—江凡
北信瑞丰—石础
富安达基金—高俊
迎水投资—蒋晨恺
平安银行—李傑
民生加银—孙金成
万家—周实
汇添富—徐逸舟
工银—杨柯、黄璐、赵完成、李磊
南方—吴凡
光大保德信—朱梦天
中庚—张传杰
长安基金—刘嘉
天治基金—王倩蓉
圆信永丰基金—马红丽
悟空投资—陈向东
高毅资产—张新和
中信建投资管—徐博
太平资产—马姣
南方—李响
交银—于畅
光大保德信—崔书田
西部利得—徐娟
鹏华—程卿云、王威

中信建投证券—秦基粟（2021.10.20，时间：14：00-15：00，现场参观）

睿格资产—陈飞
远策投资—乐奉升、颜宇恒

天风证券—李由（2021年10月21日10：00—11：00，现场参观）

交银施罗德—张三维
博时基金—高鑫
海通证券—王学思

国海证券—吴吉森、何昊（2021年10月21日14：00—15：00，电话会议）

中欧基金—李波

会议时间	2021年10月20日 9:00—9:50（开源证券） 2021年10月20日 10:00—10:50（方证证券） 2021年10月20日 14:00—15:00（中信建投证券） 2021年10月21日 10:00—11:00（天风证券） 2021年10月21日 14:00—15:00（国海证券）
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生，公司董秘办主任、 证券事务代表：沈志鹏先生，公司证券事务与投资者关系管理 专员：秦境凤女士、虞晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="color: red;">一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2021年三季度报营收情况。</p> <p>各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。</p> <p>公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列等产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET系列产品采用Fabless+封测的业务模式。</p> <p>公司2021年前三季度，在客户端的支持与关心下，在全体员工的共同努力下，实现营业收入134612.5万元，较上年同期增长94.75%；实现利润总额45181.8万元，较上年同期增长了97.74%；归属于上市公司股东的净利润为38893.7万元，较上年同期增长了100.80%。其中，晶闸管（芯片+器件）营业收</p>

入为48467.6万元，占公司前三季度营业收入的36.01%，营业成本为20711.5万元，毛利率为57.27%；防护器件（芯片+器件）营业收入为45410.6万元，占公司前三季度营业收入的33.73%，营业成本为21277.8万元，毛利率为53.14%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为37650.6万元，占公司前三季度营业收入的27.97%，营业成本为26824.7万元，毛利率为28.75%。

公司2021年第三季度实现营业收入49432.4万元，较上年同期增长74.25%；实现利润总额16502.2万元，较上年同期增长了81.60%；归属于上市公司股东的净利润为14938.4万元，较上年同期增长了94.11%。其中，晶闸管（芯片+器件）营业收入为15102.1万元，占公司第三季度营业收入的30.55%，营业成本为6745.6万元，毛利率为55.33%；防护器件（芯片+器件）营业收入16696.1万元，占公司第三季度营业收入的33.78%，营业成本为7873.5万元，毛利率为52.84%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为16440.8万元，占公司第三季度营业收入的33.26%，营业成本为10869.8万元，毛利率为33.89%。

二、主要交流问题

1、公司三季报业绩较好的原因？

答：捷捷微电2021年三季报数据比较好的主要原因：

从外部因素来看，1. 国家对半导体行业持续的支持和关注；2. 受新冠疫情影响，国外厂商产能不足或交期拉长，国产替代进口程度不断提高；3. IPO项目处在较好发挥边际效应的阶段；4. 定增项目增厚存量业务产能利用率稳步提升；5. 公司下游领域需求旺盛等。

从公司内部来看，1. 效率高，我们通过工艺改进，优化流程，提升管理水平使芯片生产周期大幅缩短；2. 优势产品的竞争能力，比如我们的晶闸管，全球市占率第一，今年经由工信部已确定授予国家级专精特新“小巨人”企业称号，以及我们

的防护器件，具有国内领先的竞争力；3. 公司芯片研发能力和定制化设计能力，公司立足于我国市场的实际情况，根据终端产品需求多样化和升级换代快的特点，依托于芯片研发设计技术优势，目前已经研发并生产多种型号和规格的标准产品，并通过对客户需求的评估生产个性化产品。公司为客户定制产品，需要结合生产工艺的调整和关键技术的协调匹配，是公司芯片研发能力的重要体现，也是公司差异化发展的重要标志；4，我们的产品结构也在不断的优化过程中，前三季度内，MOSFET占比营收达28.5%，这里面核心的就是我们的团队建设，主要表现在研发费用成果转化能力和自由现金流的投入产出比及协同能力等。至于未来，我们要脚踏实地深耕于功率半导体产业，保持功率半导体IDM核心竞争力之优势。谢谢！

2、请介绍一下公司今年产品的涨价情况，未来是否还有涨价的打算。

答：公司产品1、晶闸管，因部分原材料涨价等因素，今年3月份对产品价格作了调升，到三季度暂无涨价；2、MOSFET，今年4月初对VD MOS、TRENCH MOS部分产品进行了涨价，第三季度内，部分产品因上游产能受限等原因，价格上调了50%-60%；3、防护器件，仅部分占比不大的ESD产品因之前外协封测涨价，已经提价3%到15%不等。目前暂无其他涨价的计划，若原料市场出现小幅涨价情况，公司首先会进行内部自我消化，除非未来有原材料大幅涨价的情况，公司才会考虑产品提价。谢谢！

3、公司属于高耗高能产业吗，限电对公司有无实质影响？

答：公司不属于“两高”企业，没有列入本省市调控重点企业名单公司。公司积极配合政府临时限电停产的举措，通过加强能源日常管理、安排设备检修等方式，尽可能降低临时限电停产对公司造成的不利影响。公司将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好的沟通，并随时关注本次限电情况的

进展，以确保客户交期内的订单需求，到目前为止没有实质性的影响（阶段性，长期还要结合上下游等）。谢谢！

4、贵司下游领域主要应用、代表性客户有哪些？公司业务季节性强吗？

答：公司的下游客户分布十分广泛，客户众多。按照产品的应用领域的不同，大致分为以下类别：白色家电、小家电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电子、电动工具、摩配和光伏等。公司下游客户多且分散，应用领域宽泛，目前下游客户情况：低压电器领域主要有正泰、德力西等；家用电器领域主要有海信、美的等；防护应用领域主要有飞利浦照明、大华股份、威胜集团等；电动工具领域主要有得伟、天宁等；无功补偿、电子电力模块以及摩配领域也有众多优质客户。由于公司的下游应用领域丰富，产品涉及行业广泛，各季度的市场整体需求相对平衡，产品生产和销售受季节性影响相对较小。谢谢！

5、捷捷微电控股子公司新材料的概况，盈利状况怎么样？

答：江苏捷捷半导体新材料有限公司是捷捷微电子股份有限公司的控股子公司，成立于2020年，是专业从事半导体CMP抛光材料及金刚线硅片切割、手机盖板、蓝宝石等各种光电及电子材料表面加工材料的研发、生产、销售的高科技创新型企业。目前在半导体加工材料方面，国内产业仍十分依赖国外供应商。虽然金刚线硅片加工液大部分实现了国产，且有少部分国内厂家能够提供大尺寸集成电路半导体抛光液，但在加工液原材料及更高端的半导体STI制程（浅沟道隔离技术）上，仍然依赖于进口产品，尚没有掌握核心的制备技术，在国际贸易战的背景下，这将给我国半导体产业的发展带来潜在的隐患。捷捷半导体新材料有限公司开发的半导体加工液，通过改进技术和配方，选择新型原材料和生产工

艺，产品性能有突破性的进步，不仅可以为行业提供优质的产品，同时可借助国家政策扶持，填补国内空白，实现进口替代。同时，实施本项目对公司技术实力有明显的拉动作用，助力企业的发展，也有利于拓展公司业务，半导体加工液技术的提升，有助于公司的技术延伸。未来，捷捷新材料将把污水处理、土壤改良、生物制剂等技术作为发展方向。

因江苏捷捷半导体新材料有限公司使用的是捷捷微电的存量资产（老厂区），所以启动比较快，去年9月已拿到了环评。捷捷新材主要接触的是大客户，但大客户的认证流程一般比较缓慢，再加上受疫情影响，目前已有少量的销售订单，主要还在研发、送样、测试新产品阶段，一旦产品达标通过大客户的认证，产量会提升，捷捷新材料争取明年做到盈亏平衡。谢谢！

6、公司产品毛利较高的原因？

答：公司的晶闸管和防护器件产线（IDM）通过多年技术积累、产品升级、定制化生产、个性化服务和替代进口等，形成了较为成熟的技术工艺平台与先进制造等，产线的设计产能与产能利用率，包括产品高可靠性指标等均得到充分的提升与完善。公司晶闸管产线经过近20年的沉淀，发挥了“超边际效应”（4英寸晶园台面工艺对应的闸管系列产品），保证了公司核心业务毛利率与现金流相对稳定且较好的水准，同时公司二极管产线随产能利用率的稳步提升发挥了很好的边际效应，保持相对较高的毛利水平以及与之对应的现金流，以及MOS团队这几年的快速成长等。公司还按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，及时满足终端产品的技术升级。

同时，公司通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，最大程度地确保公司产品响应客户和行业发展的需要。因此，公司多年来，积淀了一系列的专利技术和非专利技术，在产品的

性能、工艺、质量、成本、品种、类别和制程能力等方面，具备了与国外产品相抗衡的基础，以及进口替代和自主定价能力。这些是公司保持可持续现金流和较高毛利率等主要原因。谢谢！

7、公司在手订单情况如何？

答：公司现保持着较高的产能利用率，订单上半年就已经排到了年底。受疫情影响海外工厂的产能不足与交期延后的原因，以及下游需求端（包括进口替代）增长等因素的影响，就功率半导体产业而言，整个半导体产业的趋势应该是不错的，但是由于今年受到“双控”，整个行业上下游受到限电的影响，对于政策的持续时间等存在一定的不确定因素，暂时无法估计对公司的影响。谢谢！

8、上海临港团队的概况以及下游领域有哪些？业绩怎么样？

答：公司上海临港新片区团队（控股子公司：捷捷微电子（上海）科技有限公司），创始团队由来自业界国际知名半导体公司的核心研发和管理人员组成，将坚守品质、持续创新，充分发挥技术和经验优势，把低功耗、节能环保和高频高效功率器件作为技术创新的突破目标，着力攻克MOSFET SGT等关键核心技术，助力整个捷捷微电平台的技术和产业创新发展。下游领域主要有电子烟、电动工具、家电吸尘器等。上海临港团队今年的营收目标为一个亿，截止至2021年三季度末，已经完成指标。谢谢！

9、请问公司6英寸项目的产品有哪些以及达产后预计产量是多少？

答：关于公司全资子公司捷捷半导体有限公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”建设项目，计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺。主要产品为快恢复二极管芯片及器件，IGBT模块配套用高电压大通流整

流芯片，低电容、低残压等保护器件芯片及器件，中高电压功率集成芯片，平面可控硅芯片及其他芯片产品等。该项目资金来源为捷捷半导体有限公司自有资金，总投资5.1亿元人民币。项目达产后预计可形成6英寸晶圆100万片/年及100亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力。谢谢！

10、南通高端功率半导体项目已经开工建设，请问进展如何，什么时候可以投产？

答：项目建设用地位于南通市苏锡通科技产业园区内，建设期为2年（含基础设施及配套建设），预计今年年底完成基础设施建设，计划明年二季度末或第三季度完成试生产。本项目进行高端功率半导体产业化建设，配套公司的无锡MOSFET团队和上海MOSFET团队，项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率。具体进展请关注该项目后续相关公告。谢谢！

11、请问贵司定增项目进展如何？

答：目前公司定增项目已经完成整个项目的基础设施建设和相关配套，其中“电力电子器件生产线”建设项目，募集资金已经投完，该项目增厚晶闸管的部分产能在2020年的营收中就产生了一定的贡献，今年将继续释放出一定的产能。另一个定增项目“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”建设项目，计划今年完成项目建设。具体请关注公司相关公告。谢谢！

12、请问公司的产品在充电桩领域有哪些应用，主要向哪些单位供货？

答：公司已通过IATF16949汽车行业质量体系认证，在新能源汽车方面有部分TVS产品用于充电桩上，主要是提供安全保护，主要合作客户有东风、罗思韦尔等。谢谢！

	<p style="text-align: center;">13、请问公司功率半导体“车规级”封测产业化项目进展如何？</p> <p>答：功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品以及60kk WCSP电源器件产品的生产能力。目前进展：环评已经有了，正在能评等手续办理中，预计今年年内启动项目桩基工程，明年开建。谢谢！</p> <p style="text-align: center;">14、请问公司三代半导体业务发展进展如何？</p> <p>答：公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截止至2021年第三季度末，公司拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件，此外，公司还有3个发明专利尚在申请受理中。公司目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段，后续进展情况请关注公司公告。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021-10-22